公司代码:688486　　公司简称:龙迅股份

龙迅半导体(合肥)股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素”。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,根据公司运营情况及未来资金使用规划,公司2023年度利润分配方案如下:

1.向全体股东每10股派发现金红利14.00元(含税)。截至2024年3月29日,公司总股本69,264,862股,扣除回购专用证券账户中股份总数356,697股后的股份数为68,908,165股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利96,471,431.00元(含税)。本年度公司现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为93.94%。

2.公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股,不送红股。截至2024年3月29日,公司总股本69,264,862股,扣除回购专用证券账户中股份总数356,697股后的股份数为68,908,165股,以此为基数计算,共计转增33,075,919股,转增后公司总股本为102,340,781股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额和每股转增比例不变,相应调整每股分配比例和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	龙迅股份	688486	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	赵魂	何冬琴
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋	安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋
电话	0551-68114688-8100	0551-68114688-8100
电子信箱	yzhao@lontium.com	dqhe@lontium.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1)公司主要业务

公司是一家专注于高速混合信号芯片研发和销售的集成电路设计企业,致力于为高速互通互联、高清多媒体显示提供高性能高速混合信号芯片和系统解决方案。经过长期的技术创新积累,公司已开发一系列具有自主知识产权的高速混合信号芯片产品,多款产品在性能、兼容性等方面具备了国际竞争力,产品广泛应用于安防监控、视频会议、车载显示、显示器及商显、AR/VR、PC及周边、5G及AIoT等多元化的终端场景。

公司自成立以来始终坚持以自主创新驱动企业发展,通过产品的高效迭代、技术能力的持续升级构筑全方位的竞争优势。公司的技术能力与产品性能近年来正持续受到国内外知名客户的认可。公司已成功进入多家国内外知名企业供应链。同时,高通、英特尔、三星、安霸等世界领先的主芯片厂商已将公司产品纳入其部分主芯片应用的参考设计平台中。

2)公司主要产品及服务情况

公司高速混合信号芯片产品主要可分为高清视频桥接及处理芯片和高速信号传输芯片。高清视频桥接及处理芯片主要用于多种高清视频信号的协议转换与功能处理,高速信号传输芯片主要用于高速信号的传输、复制、调整、放大、分配、切换等功能。

(1)高清视频桥接及处理芯片

公司高清视频桥接及处理芯片是视频信号从显示源到显示终端之间传输的桥梁,主要是对各种高清视频信号进行协议转换及功能处理,使得高清视频信号经桥接及处理后可以满足不同设备的使用需求。随着AI、智能汽车、AR/VR、视频会议、安防监控等下游技术革命带来高清视频显示场景的不断拓展、分辨率要求的不断提升、高清视频信号协议的不断升级,市场对于高清视频桥接及处理芯片的需求也不断上升。

公司高清视频桥接及处理芯片可实现各主流视频信号协议的转换,同时具有丰富的视频处理功能。公司多款支持不同协议的视频桥接和处理芯片,凭借良好的兼容性和稳定性,已导入车载抬头显示系统和信息娱乐系统等领域,其中有8颗芯片已通过AEC-Q100的测试,进入了多个国内外知名车企,并成功量产;公司研发的4K/8K超高清视频信号桥接芯片开始批量出货,可满足新一轮4K/8K超高清商显及VR/AR等微显示市场的需求。

公司高清视频桥接及处理芯片根据主要实现功能侧重可分为视频桥接芯片与显示处理芯片。视频桥接芯片主要功能为对各种主流高清视频信号协议进行桥接转换;显示处理芯片主要功能则侧重于显示视频与图像的处理。

①视频桥接芯片

公司视频桥接芯片用于将接收到的高清视频信号按协议格式进行桥接转换,并按指定格式输出至其他设备,实现高清视频信号在不同显示设备或协议间的兼容,可支持处理业内绝大多数当前主流协议的高清视频信号协议。

公司视频桥接芯片系列产品可兼容视觉无损压缩与解压缩技术(DSC)和高带宽数字内容加解密技术(HDCP),视频输出支持超高清、3D等内容格式,使用DSC技术最高可支持8K60Hz分辨率,音频支持S/PDIF、I2S等格式,同时可输出高比特率家庭影院音频格式,如杜比全景声和DTS:X等格式。公司视频桥接芯片广泛应用于安防监控、视频会议、车载显示、显示器及商显、AR/VR、PC及周边、5G及AIoT等下游应用场景。

②显示处理芯片

公司显示处理芯片是在视频信号桥接转换的基础上,对显示视频提供进一步处理功能,实现了转换前后显示图像内容的效果改善,提升图像显示效果。公司显示处理芯片可分为显示器控制芯片与视频处理芯片两类产品子类。显示器控制芯片内嵌MCU、LPDDR4控制器,主要用于支持图像缩放、屏幕菜单式调节方式(OSD),同时支持PWM背光控制、显示驱动等功能。视频处理芯片内嵌DDR3控制器,主要用于支持多种视频格式任意转换与视频分配、切换功能,同时可支持帧率转换、视频旋转、视频分割等功能。同时,公司显示处理芯片系列产品还具有图像旋转、梯形矫正、视频分割、色彩空间处理、亮度处理、高动态范围图像处理(HDR)、3D画面分割、视觉无损压缩与解压缩(DSC)和高带宽数字内容加解密技术(HDCP)、音频数据接收/发送、声音回传(ARL/eARL)等功能,可支持客户达到优质的视频效果。公司显示处理芯片广泛应用于视频会议、车载显示、显示器及商显等下游应用场景。

(2)高速信号传输芯片

公司高速信号传输芯片用于信号的有线传输,能实现信号的高速传输、复制、调整、放大、分配、切换等功能,在信号传输中起桥梁的作用。随着云计算、AI、5G、智能驾驶、HPC等数字新兴产业的涌现与发展,数据传输量呈现指数级上升趋势,各类高速传输协议不断更新升级,进而终端应用对于高速信号传输芯片解决方案的需求也不断攀升。公司高速信号传输芯片可支持各类视频协议信号及通讯信号的传输和交换,具有低功耗、低延迟、高带宽、高可靠性等特点。公司基于单通道12.5Gbps SERDES技术研发的通用高速信号延长芯片在5G通信领域已实现国产化应用;针对高端汽车市场对于视频长距离传输和超高清视频显示需求开发的车载SerDes芯片组已成功流片,已进入验证测试阶段;另外,公司正在进行面向HPC的数据传输和处理系列芯片的研发。

根据芯片具体实现功能,公司高速信号传输芯片可主要分为中继芯片、切换芯片、分配芯片、矩阵交换芯片。

①中继芯片

公司中继芯片主要用于高速信号的延长传输。高速信号在通过电缆或印刷电路板传输时,因信号转接或长距离传输会出现电磁干扰或信号衰减的情况,导致信号完整性受损并进而出现信号失真甚至信号畸变。公司中继芯片产品可在信号通道传输中对信号进行恢复增强,提高信号传输质量。公司中继芯片广泛应用于视频会议、车载显示、显示器及商显、PC及周边、5G及AIoT等应用场景。

②切换芯片

公司切换芯片支持多种分辨率的输入输出,主要用于多路信号输入并根据需要输出其中一路信号,单路信号输出,一般为4进1出或3进1出的规格,主要应用于安防监控、视频会议、显示器及商显、PC及周边等应用场景。

③分配芯片

公司分配芯片支持多种分辨率的输入输出,主要用于单路信号输入、多路信号输出,一般为1进2出或1进4出的规格,主要应用于安防监控、视频会议、显示器及商显、PC及周边等应用场景。

④矩阵交换芯片

公司矩阵交换芯片集成切换芯片和分配芯片的功能,可实现多路信号输入和多路信号输出。公司矩阵交换芯片可实现数据流的灵活交换,拥有高效的转发效率,能够实现通常单一总线不能达到的转发效率,满足高数据吞吐量系统的需要,信号传输速度最高为6Gbps,通过串行控制接口可进行独立的通道切换,支持直流耦合/交流耦合模式,主要应用于安防监控、视频会议、显示器及商显、PC及周边等需要多路信号交替使用的应用场景。

(二)主要经营模式

集成电路的生产过程分为设计、制造和封装测试。集成电路企业采用的经营模式一般可分为IDM模式和Fabless模式。IDM模式是指企业独立完成集成电路生产全部过程的经营模式,Fabless模式是指集成电路设计公司仅主要从事设计环节,将制造、封测的生产环节委托给代工厂的经营模式。

公司自成立起一直主要专注于集成电路研发设计和销售,以Fabless模式开展经营。公司完成芯片设计后,委托晶圆生产厂及封装测试厂进行生产与封测,在取得检测合格产品后,直接销售或通过经销商出售给下游客户。

1)研发模式

总经理和分管研发工作的副总经理负责公司研发方向规划,研发部和工程部负责公司具体的研发工作。研发部下设数字IP设计部、数字集成部、数字验证部、FPGA验证部、模拟IP设计部、时钟设计部、版图设计部等部门,工程部下设方案开发部、芯片测试验证部、终端应用开发部等部门。各部门协同合作、紧密配合,共同推进产品设计和技术研发工作。公司研发工作具体流程如下:

(1)项目立项阶段

根据市场部提供的下游市场需求、行业趋势等信息确定项目研发目标,相关研发部门准备项目可行性分析报告,提交项目立项申请。立项会议评审通过后,项目正式立项。

(2)芯片设计阶段

芯片设计阶段包括系统架构设计、数字电路设计、模拟电路设计、数字验证、FPGA验证、版图规划及设计、封装设计以及软件设计等环节。

芯片设计完成后,组织流片前评审,对照控制表完成各项设计的检查,确认各项指标符合设计要求,进行流片生产。

(3)样品试产和验证阶段

设计阶段结束后,物流采购部向晶圆生产厂和封装测试厂下达工程样品试生产和封装测试的指令。芯片验证阶段主要是对芯片的功能、性能、稳定性、可靠性等方面进行测试,以确定芯片是否达到设计标准和预期要求。通过所有验证后,进行项目评审。评审通过后,进入试量产阶段。

(4)试量产阶段

方案开发部等相关部门开发应用方案,发布硬件参考设计和软件开发包。公司进行小规模试产,试产完成后,方案开发部完成软硬件调试,收集试产阶段问题,不断优化改进,实现产品量产。

2)采购和生产模式

公司当前采用Fabless模式进行经营管理,主要专注于集成电路的研发设计和销售。公司芯片的生产通过委托晶圆生产厂和封装测试厂来完成。公司向晶圆生产厂主要采购晶圆生产服务,向封装测试厂主要采购封装测试服务。少部分产品由公司完成最后的测试环节。

(1)供应商选择

晶圆生产和封装测试环节具有集中度高的特点。公司从工艺能力、服务质量、生产能力和商务条件等方面对供应商进行综合评估,将评估通过的供应商纳入《合格供方名录》,每年从价格、质量、交期与服务等方面对供应商进行考核。考核不合格的供应商,公司将取消其合格供方资格。

(2)采购流程

市场销售部根据客户需求提供滚动的销售计划,物流采购部根据销售计划、订单需求及产品的库存情况拟定采购和生产计划,安排晶圆采购订单和封装测试订单。晶圆生产厂完成晶圆生产,通过质量检验后,公司根据需求指示其将晶圆发至指定封装测试厂;晶圆到达封装测试厂后,公司下达封装测试订单,封装测试厂按订单要求进行封装测试,芯片生产完成后暂存在封装测试厂或者按公司要求发至指定地区。

(3)委外生产质量控制

在芯片委外生产过程中,公司严格管理和跟踪委外加工全过程,保障产品质量和性能要求。具体的管理方式包括:通过优化生产参数和监控分析良率数据,不断提升产品良率;要求代工厂按照标准的控制计划进行全过程质量管控;对每颗芯片进行刻印,可追溯到晶圆生产和封装测试的生产信息。

(4)付款流程和信用政策

公司与晶圆厂商通常有生产前预付和生产完成后结算两种方式。生产前预付方式按照所签订的采购订单完成预付;生产完成后结算方式则按照产品入库和供应商进行对账,核对无误后按照约定期限完成付款。公司与封装测试厂商通常按照协议约定期限方式进行结算。公司付款均采用银行转账方式,不存在现金付款情况。

3)销售模式

公司产品为标准化产品,下游应用领域广泛,客户群体相对分散,且部分终端客户采购芯片种类较多,更倾向于通过经销商进行集中采购。因此,公司销售模式以经销为主,直销为辅。公司产品销售给经销商的方式属于买断式销售,在公司将商品交付后,商品的所有权将转移至经销商。

(1)销售流程

公司销售业务由公司总部销售部门和全资子公司朗田亩共同负责,其中总部销售部门负责国内北方地区以及境外地区产品的销售、管理以及相关后续服务,朗田亩负责国内南方地区的产品销售、管理以及相关后续服务。

在经销模式下,销售部接到客户订单后,发起订单评审流程,相关部门对产品型号、数量、价格、交期等相关条款进行评审,评审通过后根据客户的信用额度和付款情况安排出货。直销模式遵循同样的处理流程。

为了有效地满足终端客户的需求,公司通过经销区域影响力、客户资源、推广能力、技术支持能力、资金实力等方面综合筛选经销商。公司执行严格的经销商管理制度,与经销商签署年度协议。公司主要经销商为行业内知名经销商,具有较强的营销管理能力。

(2)终端客户认证流程

对于较为大型的终端客户,公司的芯片产品在导入终端客户进行批量供应前,通常需要进行产品认证;终端厂商的评估和认证流程主要根据其内部执行的供应商管理规范、产品类型、采购数量、供应商资质等因素综合考虑决定。

(3)公司及经销商客户在销售过程中的具体作用、权利与义务约定情况

经销商作为公司与下游终端客户联系的纽带,在市场拓展、客户维护、售后服务和资金流转等方面发挥了较为重要的作用,经销模式减少了公司在销售环节的资源投入,有利于公司将主要精力投入到产品研发及供应链管控环节。经销商的主要作用为:

①经销商经过多年的经营,积累了一定的客户资源,能够协助公司开拓新客户及维护客户关系,挖掘客户需求并提供售后服务,更好地辐射市场并提升客户服务能力,有利于公司将主要精力投入到产品研发环节;

②经销商能够帮助公司进行客户的日常关系维护,提高公司的业务运作效率和市场响应速度;

③经销商通常回款较快,加快了公司资金周转的速度,降低了应收账款的回收风险。

公司采用买断式经销模式,与经销商之间发生业务往来,并为经销商销售公司产品提供必要的业务及技术培训、售前售后咨询等服务,并不与终端客户直接发生交易,在终端客户前期认证过程中,公司主要负责挖掘客户需求,并根据客户的产品需求和质量要求提供相关产品信息和技术方案资料,配合终端客户进行方案开发,并视情况对产品进行改进升级。

(4)销售信用政策

公司与经销商及直销客户主要采取款到发货的结算方式,仅对少数客户采取月结的结算方式。在每次出货前物流采购部会对客户的信用额度和期限进行确认,如已超出信用额度则通知销售助理,由销售助理进行催款,收到款项后再安排出货。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司主营业务为高清视频桥接及处理芯片和高速信号传输芯片的研发及销售,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码“C39”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“新一代信息技术产业”之“新型信息技术服务”之“集成电路设计”行业,是国家重点发展的战略性新兴产业之一。

(2)行业发展阶段及基本特点

集成电路产业链由上游的EDA工具、半导体IP、材料和设备、中游的集成电路设计、晶圆制造、封装测试以及下游的系统厂商组成。集成电路行业作为全球信息产业的基础,是世界电子信息技术创新的基石,也是是当今世界科技创新的重要驱动力。集成电路行业具有生产技术工序难度高、芯片品类众多、技术迭代速度快、高投入与高风险并存等特点。公司所处的集成电路设计行业是集成电路行业的关键子行业。

集成电路设计行业主要存在IDM和Fabless两种模式。Fabless模式下,芯片设计企业专注于从事集成电路的研发设计和销售环节,将晶圆制造、封装测试环节委托给专门的晶圆代工、封装测试厂商进行生产。

集成电路设计行业是半导体产业快速发展的核心驱动环节,是引领产品定义和产品创新的关键环节,对芯片性能、成本和功能实现起到决定性作用。根据DIGITIMES预估,2023年全球IC设计和IDM产业营收将达5,230亿美元,较2022年减少8.9%。从全球半导体产业占比来看,美国仍然是半导体行业的领头羊,占比达全球近66%。而我国集成电路设计产业虽然起步较晚,但凭借着巨大的市场需求、稳定的经济发展和有利的政策环境等众多优势条件,始终保持高速稳定的增长,已成为全球集成电路行业市场增长的主要驱动力。根据中国半导体行业协会统计,2023年我国集成电路设计行业的销售预计为5,774亿元,相比2022年增长约8%。随着5G、AI、HPC、智能驾驶等新兴技术的快速发展,集成电路设计行业在行业中的核心地位愈发凸显,将为新技术、新业态的实现推广提供有力保障,拥有广阔的市场空间和发展前景。

(3)主要技术门槛

集成电路设计行业高度的系统复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒。公司主营业务为高清视频桥接及处理芯片和高速信号传输芯片的研发设计和销售,产品主要实现高清视频信号的桥接、处理、传输等功能,具有较高的技术门槛。通过长期坚定的研发投入,公司在高速混合信号电路及芯片集成、高速数据传输芯片收发、高速接口传输协议处理兼容性、高带宽数字内容保护、高清视频及音频处理等方面积累了丰富的研发经验和技术能力,在高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片领域构筑了较强的竞争壁垒。上述技术优势使得公司在主流协议覆盖面与兼容性上具备国际竞争力,公司芯片产品线可覆盖市场绝大多数主流高清视频信号协议,可支持多个主流高清视频协议的以内容最高版本,在其他主要功能上也具备一定的技术优势。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是一家专注于高速混合信号芯片研发和销售的集成电路设计企业。公司高速混合信号芯片产品主要可分为高清视频桥接及处理芯片与高速信号传输芯片。经过长期的技术创新积累,公司已开发一系列具有自主知识产权的高速混合信号芯片产品,可支持多种信号协议,广泛应用于安防监控、视频会议、车载显示、显示器及商显、AR/VR、PC及周边、5G及AIoT等多元化的终端场景。

公司通过持续的研发投入与技术探索,已掌握了多项国内领先或达到世界先进水平的核心技术。公司高度重视研发投入,在高速混合信号芯片领域已积累了丰富的知识产权。截至2023年12月31日,公司已获得境内专利100项(其中发明专利为78项),境外专利42项(全部为发明专利),集成电路布图设计专有权118项,软件著作权124项。公司自成立以来获得了“国家鼓励的重点集成电路设计企业”、“国家重点‘小巨人’企业”、“国家专精特新中小企业”、“高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”等多项荣誉与资质。

公司自成立以来始终坚持以自主创新驱动企业发展,通过产品的高效迭代、技术能力的持续升级构筑全方位的竞争优势。公司的技术能力与产品性能近年来正持续受到国内外知名客户的认可。公司已成功进入多家国内外知名企业供应链。同时,高通、英特尔、三星、安霸等世界领先的主芯片厂商已将公司产品纳入其部分主芯片应用的参考设计平台中。

公司将坚持深耕于高速混合信号芯片领域,以“为数字世界创新数模混合信号技术”为使命,致力于通过技术创新提供高性能的芯片解决方案。公司将通过现有产品线的持续迭代升级以及新产品线的多元化开拓,力争成为世界领先的高速混合信号芯片方案提供商。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来,随着显示技术和消费电子的蓬勃发展,高清视频技术已普遍应用于众多终端场景。超高清视频技术作为电子信息领域的战略性新兴产业,是继视频数字化、高清化之后的新一轮重大技术革新,是引领信息消费升级、驱动行业智能化转型的具有代表性的产业,也是推动高质量发展、构建新发展格局的重要抓手。高清视频通过与5G、AI技术加速融合创新,催生了大量新需求、新场景、新模式,正在向各行业、各领域纵深发展,成为千行百业数字化转型的重要赋能力量。新媒体领域,推动终端产品的升级换代;文教娱乐领域,提供更生动的体验和更丰富的视频内容;医疗健康领域,提供超精细图像,提高医学摄影的解析度;安防监控领域,有效提升复杂环境下识别、感知正确率等。

同时,随着音视频技术不断迭代升级,高清视频产业正引发信息技术领域新一轮集群式创新突破,迈入了更高智能、更强体验、更多元应用的高质量发展新阶段。家庭视听系统,包括8K电视、折叠屏手机、智能音箱、智能交互大屏、VR/AR以及应用于家庭娱乐、教育、健身、起居等场景的新型智能终端,应用量大面广,增长潜力旺盛,将成为未来产业拉动和内需消费提升的重要引擎;车载视听系统,新能源汽车、智能网联汽车发展迅猛,基于智能座舱构建的包括车载音响、摄像头、中控大屏、仪表台、抬头显示、后座娱乐、智能导航等设备和终端的将培育新增量,其中,车载显示赋能智能驾驶新体验,将逐渐成为“第三生活空间”的核心人车交互设备;会议视听系统,未来混合办公发展的新趋势,主要包括智能拍摄设备、会议终端、传输网络、控制单元、系统管理软件等环节;网络直播系统,主要包括应用于广播电视之外,企业和个人直播使用的摄像机、摄影机、网络导播台、视频编解码器、实时渲染平台、数字人等产品和服务;商用显示系统,广泛应用于教育、安防、零售、医疗、金融、航空等领域,包括商显大屏、教育白板、数字标牌、激光投影、小间距LED等。

另外,近年来,高清视频行业受到各级政府的高度重视,自2019年工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台等部门发布《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》以来,国务院、国家广播电视总局等已陆续印发多项促进超高清视频显示产业的发展政策。2023年12月,为了促进以超高清视频为代表的视听产业的发展,工业和信息化部等七部门印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》,更是提出了产业发展的中长期目标:到2027年,我国视听电子产业国际竞争力显著增强,基本形成创新能力优、产业韧性强、开放程度高、品牌影响大的现代化视听电子产业体系,培育若干千亿级细分新市场。到2030年,我国视听电子产业整体实力进入全球前列,技术创新达到国际先进水平,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,把握产业生态主导权,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡发展局面,构建现代化视听电子产业体系。可以看到,在政策的支持下,超高清视听时代国路到来。

从产业链来看,高清视频产业涉及到数十个相关产业,包括核心元器件、视频生产设备、网络传输设备、终端呈现设备等。其中,高清视频芯片是高清视频产业发展的重要基础产业。

根据高清视频影像处理流程,主要分为影像采集、发送端影像处理、信号传输、接收端影像处理、影像显示等环节。在影像采集环节中,实际影像由镜头汇聚,通过传感器将影像分解为像素转化为电信号,并通过模数转换器将电信号转换为数字信号。在发送端影像处理环节,数字信号经处理芯片进行格式处理、画质提升和视频压缩编码等初步处理。在信号传输环节,视频信号经一定媒介进行传输,信号传输芯片可以提高信号传输的速率与质量。在接收端影像处理环节,视频信号通过各类芯片进行解码、协议格式处理以及其他视频显示处理,最终在显示终端上得到高清高质量视频图像。高清视频影像处理环节和信号传输环节中通常涉及不同信号之间的传输和处理,因此需要每个环节均需要特定功能的高清视频芯片进行支持方能实现。

高清视频芯片是视频信号传输加工的桥梁,在高清视频影像采集、处理、传输和显示中起到重要作用。根据支持环节及实现功能类型的不同,高清视频芯片主要可分为三类。根据支持环节和实现功能类型的不同,高清视频芯片主要可分为三类。第一类主要为和显示屏相关的显示驱动芯片和显示时序控制芯片;第二类是主要为和视频图像处理、桥接及信号传输相关的高清视频桥接芯片、高速信号传输芯片、视频图像处理芯片;第三类是主要为和视频图像处理和编解码相关的视频编解码的SoC芯片,如电视SoC、机顶盒SoC、网络摄像机SoC等芯片。此外,影响采集环节中也需要使用镜头传感器等半导体元器件。三类芯片具有截然不同的核心功能,在视频应用中相辅相成,构成完整的视频链路解决方案,各细分行业长期处于共同发展态势。

随着高清视频技术与人类社会的交融不断深化,高清视频产业高质量发展局面正在加速形成,也就意味着高清视频芯片市场也将持续增长,根据赛迪数据显示,我国超高清视频产业规模以年均约46%的速度增长,2022年达到3.4万亿元,预计2023年可达到4万亿元,到2025年将突破7万亿元;根据CINNO Research统计预计,2025年全球高清视频芯片市场规模将达到1,897亿元人民币。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,486,536,902.57	359,687,379.31	313.29	331,318,328.90
归属于上市公司股东的净资产	1,429,466,358.91	316,162,198.27	352.13	275,400,775.76
营业收入	323,147,354.00	240,937,698.29	34.12	234,803,644.19
归属于上市公司股东的净利润	102,695,394.40	69,205,460.39	48.39	84,067,413.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,801,676.10	56,770,204.57	17.67	71,037,172.37
经营活动产生的现金流量净额	103,412,018.58	37,427,044.09	176.30	92,025,157.30
加权平均净资产收益率(%)	8.45	24.21	减少15.76个百分点	35.90
基本每股收益(元/股)	1.55	1.33	16.54	1.62
稀释每股收益(元/股)	/	/	/	/
研发投入占营业收入的比例(%)	23.06	22.99	增加0.07个百分点	21.23

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	51,647,363.64	82,279,426.48	88,176,178.44	101,044,385.44
归属于上市公司股东的净利润	7,299,075.90	34,650,705.07	28,465,809.79	32,279,803.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,838,062.06	23,298,387.27	20,438,885.75	18,226,341.02
经营活动产生的现金流量净额	6,718,029.62	46,657,883.92	14,967,727.23	35,068,377.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	2,832
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	2,932
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
FENG CHEN	0	25,947,884	37.47	25,947,884	25,947,884	无	0	境外自然人
合肥赛富合元创业投资中心(有限合伙)	0	5,285,824	7.63	5,285,824	5,285,824	无	0	其他
安徽红土创业投资有限公司	0	3,523,904	5.09	3,523,904	3,523,904	无	0	境内非国有法人
合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,493,318	3.60	2,493,318	2,493,318	无	0	其他
邱成英	0	2,389,431	3.45	2,389,431	2,389,431	无	0	境内自然人
Lonex Holding Limited	0	2,378,624	3.43	2,378,624	2,378,624	无	0	境外法人
合肥纪财富信息技术中心(普通合伙)	0	2,293,853	3.31	2,293,853	2,293,853	无	0	其他
华富瑞兴投资管理有限公司	0	2,077,765	3.00	2,077,765	2,077,765	无	0	境内非国有法人
合肥海恒投资集团有限公司	0	2,017,075	2.91	2,017,075	2,017,075	无	0	国有法人
全国社保基金一一四组合	1,530,851	1,530,851	2.21	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	FENG CHEN持有总财富0.87%合伙企业财产份额并为执行事务合伙人;邱成英系FENG CHEN母亲;海恒集团持有赛富创投13.96%的合伙企业财产份额,同时,海恒集团通过其控股子公司合肥经济技术开发区产业投资引导基金有限公司间接持有合肥中安26.53%的合伙企业财产份额。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

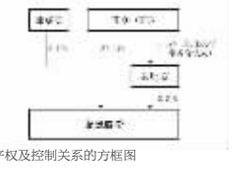
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入32,314.74万元,实现归属于母公司所有者的净利润10,269.54万元,报告期末,公司总资产为148,653.69万元,归属于母公司的所有者权益为142,946.64万元。

2公司年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688486　证券简称:龙迅股份　公告编号:2024-026

龙迅半导体(合肥)股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 分配及转增比例:每10股派发现金红利14.00元(含税),同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4.8股,不送红股。

● 因公司实施股份回购事项,根据相关规定,公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专户中的股份数量发生变动的,公司拟维持分配总额和每股转增比例不变,相应调整每股分配比例和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)归属于母公司所有者的净利润102,695,394.40元,母公司期末可供分配利润为234,419,511.29元,资本公积为1,075,009,528.11元。

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,根据公司运营情况及未来资金使用规划,公司2023年度利润分配方案如下:

1.向全体股东每10股派发现金红利14.00元(含税)。截至2024年3月29日,公司总股本69,264,862股,扣除回购专用证券账户中股份总数356,697股后的股份数为68,908,165股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利96,471,431.00元(含税)。本年度公司现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为93.94%。

2.公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股,不送红股。截至2024年3月29日,公司总股本69,264,862股,扣除回购专用证券账户中股份总数356,697股后的股份数为68,908,165股,以此为基数计算,共计转增33,075,919股,转增后公司总股本为102,340,781股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额和每股转增比例不变,相应调整每股分配比例和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,全体董事一致同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2023年3月29日召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司2023年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素,符合公司及全体股东的利益。综上,我们同意《关于2023年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:688486　证券简称:龙迅股份　公告编号:2024-029

龙迅半导体(合肥)股份有限